



Comunicato Stampa Gruppo IIS

Appuntamento a Cinisello Balsamo (UCIMU) il 26 maggio 2016

Ritorna "Feel weld! 2" "Sentire la saldatura"

"Recenti sviluppi ed indirizzi per Robotica, Sensoristica ed Intelligenza Artificiale applicati alla saldatura"

*Concedono il Patrocinio SIRI ed UCIMU,
mentre SIAD è il primo "sponsor"*

Genova - Continua alla grande l'organizzazione della seconda edizione di "Feel weld! / Sviluppi ed indirizzi per Robotica, Sensoristica ed Intelligenza Artificiale applicati alla saldatura", in programma nell' Area Metropolitana di Milano (Cinisello Balsamo) presso la sede UCIMU - con il Patrocinio di SIRI e della stessa UCIMU - per il giorno 26 maggio 2016.

Nelle ultime ore alcune novità interessanti: la prima che la manifestazione ha ottenuto il Patrocinio di SIRI (Associazione Italiana di Robotica ed Automazione) e di Uciimu-Sistemi per Produrre, mentre SIAD, oltre presentare una memoria, è anche primo sponsor della manifestazione. Inoltre, il giornale "L'ammonitore" è entrato a far parte dei "Media Partner".

Intanto, l'Ing. Elisabetta Sciacaluga, Funzionario IIS Responsabile Tecnico della manifestazione, sta avendo importanti contatti con il mondo dell'automazione per la formazione del programma e delle memorie che saranno presentate.

A tal proposito, ricordiamo che sono valutati contributi di carattere tecnicoscienfifico riconducibili ai temi di interesse della manifestazione. Per una prima valutazione da parte della Commissione, è sufficiente l'invio del titolo della memoria, dei possibili relatori e di un Abstract che contenga le informazioni necessarie per coglierne il valore.

Previa accettazione, la proposta sarà formalmente inclusa nel programma preliminare di "Feel Weld! 2" e sarà richiesto agli autori il testo completo e definitivo della memoria in tempo utile per la sua pubblicazione negli Atti della manifestazione (indicativamente per marzo 2016).

Sono ammessi interventi riconducibili ai temi di interesse di seguito riportati:

- Applicazioni robotizzate in saldatura e nei controlli non distruttivi di prodotti saldati: soluzioni attraverso robotizzazione di problematiche complesse di gestione del processo di fabbricazione mediante saldatura, in vari settori industriali e per differenti materiali;

- Impiego di intelligenza artificiale, reti neurali e comando adattivo nei sistemi robotizzati utilizzati nell'ambito della realizzazione di giunzioni saldate e relativi controlli.

Particolare attenzione sarà rivolta a casi che abbiano trovato effettiva applicazione in ambito industriale, ivi compresa la trattazione di tematiche inerenti la qualificazione e certificazione di personale/processo/prodotto.

Chi volesse proporre contributi non direttamente riconducibili ai temi di interesse, ma comunque collegati a sistemi robotizzati in saldatura, potrà inviare, con analoghe modalità, la propria proposta alla Commissione che si riserverà di effettuare le valutazioni del caso.

Ricordiamo che il termine ultimo per la presentazione del titolo della proposta di memoria, dei possibili autori e dell'Abstract è fissato per il prossimo 30 novembre 2015.

Per l'invio delle proposte, è disponibile l'indirizzo di posta elettronica feelweld@iis.it.

Per ogni ulteriore informazione inerente la manifestazione è possibile fare riferimento al referente tecnico-scientifico:

Ing. Elisabetta Sciaccaluga - elisabetta.sciacaluga@iis.it - tel. 010.8341.515.

Info:

Rosario Russo / Responsabile Manifestazioni Tecniche IIS

rosario.russo@iis.it / 010.8341.476

Elisabetta Sciaccaluga / Responsabile Tecnico di "Feel Weld! 2"

elisabetta.sciacaluga@iis.it / 010.8341.515

Franco Ricciardi / Responsabile Sponsorizzazioni

franco.ricciardi@iis.it / 010.8341.389

Cinzia Presti / Referente Sponsorizzazioni

cinzia.presti@iis.it / 010.8341.392

Ivana Limardo / Segreteria Organizzativa, informazioni e iscrizioni

ivana.limardo@iis.it / 010.8341.373

Con preghiera di pubblicazione / divulgazione.

Grazie per l'attenzione. Nel caso di pubblicazione chiediamo gentilmente di essere informati (ufficiostampa@iis.it)

